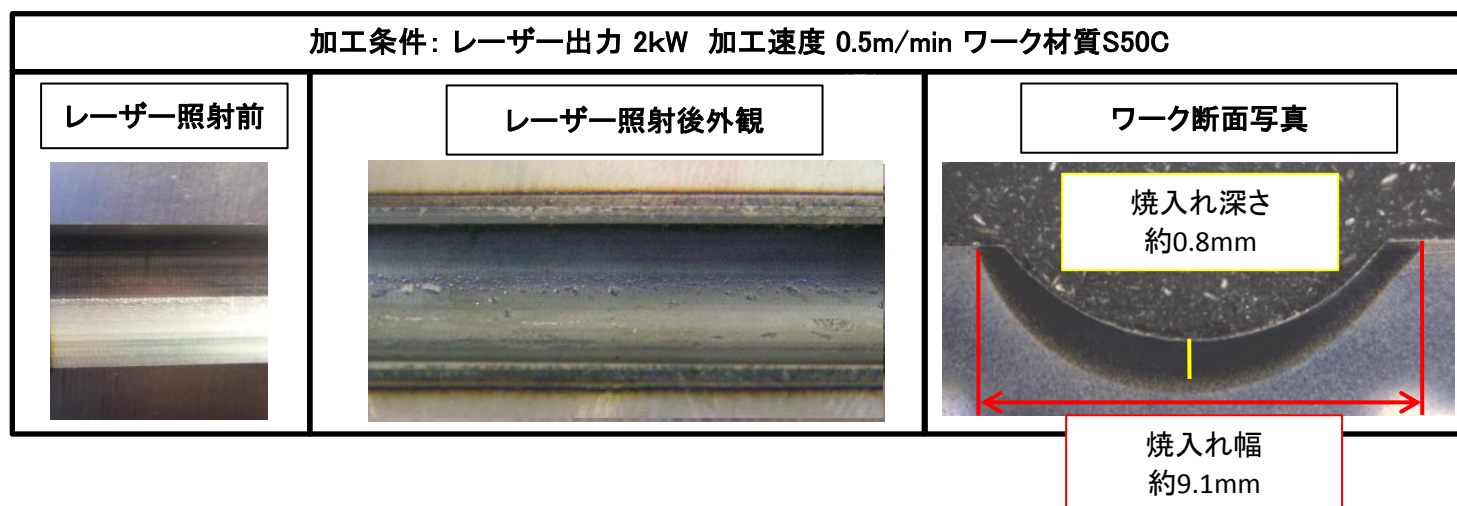


LBM10 で焼入れサンプル作製

こんにちは。エンシュウ株式会社 工作機械・レーザー事業部の左右田です。

今回の加工レポートは、先日東京ビックサイトで行なわれた「JIMTOF2014」に出展しました「レーザー加工機LBM10」で作製した、焼入れサンプルについてご紹介いたします。

焼入れサンプルとして、一般的に焼入れで 사용되는「S50C」を選択しました。下写真は、焼入れサンプルを作製する時の最適な加工条件を探すためのワークです。



ワーク断面写真で、最大焼入れ深さが約0.8mmほど入っていることが分かります。硬度測定により、硬度単位「Hv」で750以上まで硬くなっていることを確認しています。

そして、実際のワークに加工した焼入れサンプルがこちらです。(下写真)四隅のカーブしている所は加工速度を調節することで、きれいな外観になりました。

材質S50C 使用レーザー: 2kW半導体レーザー 加工速度0.5m/min



レーザー焼入れ加工はまだ広く実用化は進んでおりませんが、エンシュウでは今まで多くの焼入れ加工を行っており、その加工データから多種多様な焼入れに対応することが可能です！

今後もさらに改善し、良い品質の物をご紹介出来るよう努めていきます。